

PARAT SMP



Elastischer Parkettklebstoff

Anwendungsbereich:

Einkomponenten-Klebstoff nach DIN 14293 und ISO 17178 auf neuartige weiterentwickelte Hybrid-Technologie für die elastische Verklebung von:

Mosaikparkett: Mosaikparkett Würfel 8 mm stark, Mosaikparkett Verband 8 mm stark.

Mehrschichtparkett: Mehrschichtparkett 70 x 490/500 mm, Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm, Mehrschichtdielen < 250 cm, Stabparkett bis 22 mm Dicke auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, wie Zementestrich, Calciumsulfat-(fließ)estrich und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten Untergründen.

Besondere Vorteile:

- gute Streichfähigkeit
- Mehrschichtparkett
- Stabparkett bis 22 mm Dicke

Technische Angaben:

Basis:	Silanterminierte Polymere (SMP)
Farbe:	beige
Viskosität:	Streichfähig, standfest
Spez.-Gewicht:	ca. 1,75 g/cm ³
Einlegezeit (+ 23°C/50 % rel. F.):	ca. 20 Minuten
Verarbeitungsbedingungen:	Am besten zwischen + 18 °C und + 23 °C; Untergrundtemperatur mind. + 15 °C; Lufttemperatur mind. + 18 °C. Nicht über 65 % rel. Luftfeuchte

Empfohlene Spachtelzahnung:	B3 (ca. 800 - 900 g/m ²) Mosaikparkett Würfel 8 mm stark, Mosaikparkett Verband 8 mm stark
	B11 (ca. 1000 - 1200 g/m ²) Mehrschichtparkett 70 x 490/500 mm, Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm, Stabparkett bis 22 mm Dicke
	B12 (ca. 1100 - 1300 g/m ²) Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm, Mehrschichtdielen < 250 cm
	B15 (ca. 1200 - 1400 g/m ²) Mehrschichtdielen < 250 cm

Die genannten Zahnungen gelten als Hilfestellung, eine endgültige Auswahl der Zahnung kann nur baustellenbezogen getroffen werden, da sie sich nach der Ebenheit des Untergrundes, Länge der Parketelemente und der Parketrückseite richtet. Es ist auf jeden Fall auf eine ausreichende Benetzung der Parketrückseite zu achten.

Belastbar:	Nach 24 - 48 Stunden
Oberflächenbehandlung:	Frühestens nach 48 Stunden, je nach Parkettart, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima.
Eignung auf Fußbodenheizung:	Ja - Entsprechende Merkblätter und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.
GISCODE:	RS 10 (Diese Klebstoffe sind Ersatzstoffe für stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, bei deren Verarbeitung die Arbeitsplatzgrenzwerte überschritten werden (GISCODE S 1 – S 6))
GEV-EMICODE:	EC 1 R - sehr emissionsarm
GefStoffV:	entfällt
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Für nicht ausgehärteten Klebstoff: Verdüner
Lagerung:	6 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebände. Kühl und trocken lagern zwischen +5° C und + 25° C.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18356 "Parkettarbeiten" eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein und ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Besondere parkettspezifische Untergrundanforderungen und Vorbereitungen sind den technischen Produktinformationen der Parketthersteller zu entnehmen.

Zementestrich (ZE) bei Direktklebung:

Geschliffenen Zementestrich sorgfältig mit Industriestaubsauger absaugen. Keine Grundierung einsetzen.

Calciumsulfatfließestriche (CAF) bei Direktklebung:

CAF nach aktuellem BEB Merkblatt anschleifen und sorgfältig mit Industriestaubsauger absaugen. Keine Grundierung einsetzen.

Gussasphaltestrich (GE) bei Direktklebung:

Neue gut abgesandte GE sorgfältig mit Industriestaubsauger absaugen. Keine Grundierung einsetzen.
Alte GE mit **2-K-Epoxidharz-Grundierung PARAT 98 E** grundieren und anschließend im frischen Zustand mit Quarz-sand abstreuen.

Entsprechen vorgenannte Untergründe nicht der Ebenheit nach DIN 18202 „Maßtoleranzen im Hochbau“ sind diese mit geeigneten Grundierungen und Spachtelmassen vorzubereiten.

Verarbeitung:

PARAT SMP mit einem gezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, das Verlegeelement sofort in das Klebstoffbett einlegen und gründlich anklopfen. Parkettenden sind bei Bedarf zu beschweren. Klebstoffflecken auf dem Parkett sofort mit z. B. Bohnerwachs entfernen.

Beachten Sie die Hinweise der Parkett- und Laminathersteller, insbesondere die Verarbeitungsbedingungen und die Klebeeignung der eingesetzten Beläge.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.